

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2026-027

四会富仕电子科技股份有限公司

关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及 填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对摊薄即期回报的影响进行了认真的分析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年11月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准；

3、根据公司已披露的《四会富仕电子科技股份有限公司2025年度报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润及2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为12,812.28万元及11,338.60万元；

4、假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2025 年度的基础上考虑上升 15%、持平、下降 15% 三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

5、假设 2026 年不进行利润分配；

6、在预测公司总股本及相关指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。截至本次董事会会议召开日，公司总股本为 160,521,165 股，假设本次发行的股票数量为发行上限，即发行股票数量为 48,156,349 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将达到 208,677,514 股；

7、本次测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；

8、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算本次向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	发行前（2026 年度 /2026 年 12 月 31 日） （预测）	发行后（2026 年度 /2026 年 12 月 31 日） （预测）
总股本（万股）	16,052.12	16,052.12	20,867.75
情形 1、假设 2026 年公司净利润较 2025 年上升 15%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,812.28	14,734.12	14,734.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,338.60	13,039.39	13,039.39
基本每股收益（元/股）	0.88	0.92	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.92	0.90
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.78	0.81	0.79
扣除非经常性损益后稀	0.78	0.81	0.79

释每股收益（元/股）			
情形 2、假设 2026 年公司净利润较 2025 年持平			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,812.28	12,812.28	12,812.28
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,338.60	11,338.60	11,338.60
基本每股收益（元/股）	0.88	0.80	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.80	0.78
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.78	0.71	0.69
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.78	0.71	0.69
情形 3、假设 2026 年公司净利润较 2025 年下降 15%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,812.28	10,890.44	10,890.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,338.60	9,637.81	9,637.81
基本每股收益（元/股）	0.88	0.68	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.68	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.78	0.60	0.59
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.78	0.60	0.59

注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

二、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，募集资金投资项目释放经济效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

同时，公司在测算本次发行对即期回报摊薄影响中使用的假设并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等于公司对未来利润作出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担相关赔偿责任，提请广大投资者注意。

三、本次向特定对象发行 A 股股票的必要性和合理性

本次发行募集资金投资项目经过了公司的严格论证，项目的实施有利于公司进一步提高核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见《四会富仕电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金项目与现有业务的关系

公司专注于 PCB 主业，持续推进高端产能扩建，并通过技术创新和智能化升级，保持核心业务的稳步增长。公司本次向特定对象发行募集资金投资的项目系围绕公司主营业务开展，是公司业务发展、产业升级的现实需求，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向。

通过本次募集资金投资项目的实施，围绕公司核心业务布局，重点扩产高多层板和 HDI 板等高端产能，项目将通过引入智能化设备、优化生产工艺、突破关键技术瓶颈，满足工控、汽车电子产能需求的同时，突破 AI、服务器、光模块等前沿应用领域对高端 PCB 的需求，有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，同时有助于充实公司资本实力，优化公司财务结构，提高抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

自公司成立以来，一直将人才团队的建设与培养视为公司主要的发展目标之一。在人员储备方面，公司拥有一批专业知识扎实、自主研发创新能力强、实战经验丰富的专业研发人才团队，核心技术人员均为印制电路板行业的资深专家，具有长期、丰富的生产及技术研究开发经验。同时公司已经形成了一套成熟的管理制度与研发制度，组建了一支多层次、专业性强、经验丰富的管理团队和研发团队。且公司地处珠三角一隅，员工主要以本地为主，稳定度强，流失率低，人才储备充足，有助于公司实现高效稳定的管理，顺利应对市场环境变化，保持持续、稳定的创新

能力，为本次募集资金项目的顺利实施提供了重要保障。

且公司各部门将按照本次募集资金投资项目的实施计划，对所需的专业人员进行提前规划，使得募集资金投资项目拥有充足且专门的人力储备。同时，针对募集资金投资项目所需要的新技术，公司也将加强相关人员的培训工作，确保相关人员能够胜任相关工作。

2、技术储备

公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等荣誉称号。

公司作为国内领先的印制电路板制造商，长期以来，一直坚持技术驱动市场发展战略，紧密关注行业的核心技术发展动态，及时获取前沿技术信息，以在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性。且公司的主要客户均为世界知名行业领先企业，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，也可及时掌握客户需求的变化及当下最前沿的产品标准及技术情况并进行对应的技术前期开发。

经过公司研发团队长期自主研发，公司已相继开发高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜(铜厚 4oz~15oz) PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术，截至本文件公告日，公司已经取得授权专利 35 项，其中发明专利 19 项，通过这些技术的运用，公司可向工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械、新能源、光模块、AI 服务器等高可靠性要求的产品领域提供相应产品，满足不同客户的需求。未来公司还将进一步加大研发相关的投入，提高相关新技术的产出能力、相关技术人才的管理能力，为本次募投项目的顺利实施提供强有力的技术保障。

3、市场储备

公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等荣誉称号。

公司作为国内领先的印制电路板制造商，长期以来，一直坚持技术驱动市场发展战略，紧密关注行业的核心技术发展动态，及时获取前沿技术信息，以在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性。且公司的主要客户均为世界知名行业领先企业，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，也可及时掌握客户需求的变化及当下最前沿的产品标准及技术情况并进行对应的技术前期开发。

经过公司研发团队长期自主研发，公司已相继开发高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜(铜厚 4oz~15oz) PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术，截至本文件公告日，公司已经取得授权专利 35 项，其中发明专利 19 项，通过这些技术的运用，公司可向工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械、新能源、光模块、AI 服务器等高可靠性要求的产品领域提供相应产品，满足不同客户的需求。未来公司还将进一步加大研发相关的投入，提高相关新技术的产出能力、相关技术人才的管理能力，为本次募投项目的顺利实施提供强有力的技术保障。

综上，公司在人员、技术和市场等方面具备丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

五、公司应对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施

(一) 大力推进募投项目建设，增强公司盈利能力

公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

（二）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》并将依此严格管理募集资金。同时，公司将合理安排项目投资进度，提升募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设以如期实现本次募投项目的投产，尽早产生效益以回报公司股东。

（三）优化投资回报机制

为了积极回报投资者、保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已制定《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。同时公司也建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制等。届时，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者的相关合法权益，有效维护和增加对投资者的回报。

（四）进一步加强经营管理和内部控制，为公司发展提供保障

本次发行完成后，公司的业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化，公司的抗风险能力及核心竞争力也将得到进一步增强。

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，不断加强公司经营管理，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司长期稳定的发展提供坚实的制度保障。

上述填补回报措施不等于对公司未来的利润情况做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相关赔偿责任，敬请广大投资者注意相关的投资风险。

六、公司相关主体对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东四会市明诚贸易有限公司，实际控制人刘天明、温一峰、黄志成承诺如下：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺出具后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求且上述承诺不再满足相关规定的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本公司/本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意根据相关法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。”

（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求且上述承诺不再满足相关规定的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。”

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日